



WHITE PAPER

Indien in der Elektronikfertigung: PCB, Baugruppen und Materialbeschaffung im Realitätscheck

Eine strategische Bestandsaufnahme der Leiterplattenfertigung, Baugruppenmontage und Bauteilbeschaffung – Stand Juli 2026, mit Ausblick und Folgen für Europa

EMS Strategy Group

Juli 2026

Ausgangslage

Indien gewinnt als Standort für die Elektronikfertigung zunehmend an Bedeutung. Steigende Investitionen, staatliche Förderprogramme und geopolitische Entwicklungen führen dazu, dass das Land immer häufiger als zukünftige Alternative oder Ergänzung zu China betrachtet wird. Gleichzeitig wird die tatsächliche Leistungsfähigkeit des indischen Elektroniksektors häufig pauschal bewertet – obwohl sich die einzelnen Bereiche der Wertschöpfung sehr unterschiedlich entwickelt haben.

Für eine realistische Einschätzung müssen drei Bereiche getrennt betrachtet werden: die Fertigung von Leiterplatten (PCB), die Baugruppenfertigung (PCBA/EMS) sowie die Beschaffung elektronischer Bauteile. Jeder dieser Bereiche verfügt über eigene Marktstrukturen, Investitionszyklen und Entwicklungsstände.

Dieses White Paper analysiert den Status quo dieser drei Segmente auf Basis des Marktstands im Juli 2026. Darüber hinaus werden die absehbaren Entwicklungen der kommenden zwei bis drei Jahre sowie deren Auswirkungen auf europäische OEMs und deren Beschaffungsstrategien eingeordnet. Abschließend wird bewertet, welche Rolle Indien künftig innerhalb globaler Elektroniklieferketten übernehmen kann – und welche Chancen und Herausforderungen sich daraus für den Industriestandort Europa ergeben.

Teil 1: PCB-Herstellung – die Leiterplatte selbst

Stand Juli 2026

Die indische Leiterplattenindustrie befindet sich in einer Phase des Kapazitätsaufbaus. Neue Investitionen und staatliche Förderprogramme stärken den Ausbau lokaler Fertigung, wobei der Schwerpunkt derzeit noch überwiegend auf Standard- und mittleren Technologiesegmenten liegt [1][2].

Technologisch bleibt die Fertigung überwiegend im Standardsegment: 4- bis 8-lagige Boards mit mittleren Toleranzen sind heute die Regel. AT&S India (Nanjangud) stellt mit HDI-Fertigung für IC-Substrate eine der wenigen technologischen Ausnahmen dar. Für komplexe Anwendungen wie gestapelte Mikro-Vias, hohe Lagenzahlen (14+) und Flex-Rigid-Leiterplatten sind viele indische Anbieter weiterhin auf internationale Lieferketten mit Partnern aus Taiwan oder China angewiesen [1][7].

Ausblick

Die Investitionsrichtung ist klar erkennbar, die technologische Entwicklung benötigt jedoch Zeit. Neue Fertigungslinien müssen qualifiziert, Prozesse für höhere Komplexität aufgebaut und qualifizierte Fachkräfte entwickelt werden. Eine schrittweise Erweiterung in Richtung 10- bis 12-Lagen-Technologien erscheint in den kommenden zwei bis drei Jahren realistisch. Ein flächendeckendes Erreichen des heutigen chinesischen HDI-Niveaus ist dagegen mittelfristig noch nicht absehbar.

Teil 2: Baugruppenfertigung (EMS) – Bestückung und Montage

Stand Juli 2026

Die Baugruppenfertigung zählt zu den am weitesten entwickelten Bereichen der indischen Elektronikindustrie. Neben internationalen EMS-Unternehmen hat sich eine breite Schicht spezialisierter indischer Anbieter etabliert, die von den staatlichen Förderprogrammen und der zunehmenden Verlagerung globaler Elektronikproduktion profitieren [3].

Zu den bedeutenden indischen EMS-Anbietern gehören unter anderem Dixon Technologies (breit diversifiziert, insbesondere im Bereich Consumer Electronics), Syrma SGS (unter anderem Medizintechnik, Automotive und RFID), Avalon Technologies (integrierte Fertigung einschließlich Kabelkonfektion und Box-Build) sowie Kaynes Technologies (zunehmend mit ODM- und Entwicklungsleistungen) [3].

Von der reinen Montage zum Design-Partner

Parallel zum Kapazitätsausbau entwickeln sich einige Unternehmen vom klassischen Auftragsfertiger hin zu integrierten Elektronikpartnern mit erweiterten Kompetenzen in Entwicklung, Design, Engineering und Komponentenintegration. Dieser Wandel wird durch staatliche Programme zur Erhöhung der lokalen Wertschöpfung unterstützt [4].

Ausblick

Bei der Baugruppenfertigung ist die Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Produktionskapazitäten wurden erweitert, internationale Kundenbeziehungen aufgebaut und die Skalierung bestehender Standorte schreitet weiter voran. Für Standardprodukte im Konsumgüterbereich (Smartphones, TV-Geräte oder Haushaltsgeräte) hat sich Indien bereits heute als etablierter und wachsender Fertigungsstandort positioniert.

Anders stellt sich die Situation bei hochkomplexen, kleinserienorientierten oder stark regulierten Anwendungen dar. In Bereichen wie Medizintechnik, Automotive-Safety, Industrieelektronik, Luft- und Raumfahrt sowie anspruchsvoller Leistungselektronik zählen Deutschland und andere europäische Fertigungsstandorte aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung, hohen Qualitätsstandards und ausgeprägten Engineering-Kompetenz weiterhin zu den international führenden Regionen. Umfangreiche Zertifizierungen, ausgereifte Qualitätsmanagementsysteme sowie eine hohe Prozess- und Entwicklungskompetenz bilden hier einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil.

Indien baut seine Fähigkeiten in diesen Marktsegmenten zwar kontinuierlich aus, ein breiter Nachweis vergleichbarer Kompetenzen über eine größere Zahl von EMS-Anbietern hinweg steht derzeit jedoch noch aus. Einzelne Unternehmen wie Syrma SGS zeigen bereits, dass entsprechende Technologien und Fertigungskompetenzen vorhanden sind.

Teil 3: Materialbeschaffung – die eigentliche Schwachstelle

Stand Juli 2026

Während die Kapazitäten in der Baugruppenfertigung und teilweise auch in der Leiterplattenproduktion deutlich ausgebaut werden, bleibt die lokale Verfügbarkeit elektronischer Komponenten eine der größten Herausforderungen für den indischen Elektronikstandort. Ein erheblicher Anteil wichtiger Bauteile und Vorprodukte wird weiterhin aus internationalen Lieferketten bezogen, insbesondere aus China und Taiwan [5][6][7].

Die Regierung hat diese Abhängigkeit erkannt und fördert den Aufbau einer lokalen Komponentenindustrie. Rund 75 Bauteil-Fertigungsprojekte befinden sich aktuell in Umsetzung, weitere Projekte für die kommenden Jahre wurden angekündigt. Das Spektrum reicht von passiven SMD-Komponenten über Steckverbinder bis hin zu Batteriezellen [4][6].

Ausblick

Von den drei betrachteten Bereichen ist die Materialbeschaffung der Bereich mit dem größten Aufholbedarf. Gleichzeitig begrenzt sie die Möglichkeit, eine vollständig unabhängige Elektronik-Wertschöpfungskette innerhalb Indiens aufzubauen.

Auch bei einer vollständig in Indien montierten Baugruppe bleiben viele Hersteller auf absehbare Zeit auf internationale Zulieferstrukturen für Komponenten und Materialien angewiesen. Eine Verlagerung der Montage nach Indien bedeutet daher nicht automatisch eine vollständige Unabhängigkeit von asiatischen Lieferketten.

Der Aufbau einer stärker lokalisierten Komponentenindustrie ist ein mehrjähriger Entwicklungsprozess. Die indische Regierung verfolgt dabei einen schrittweisen Lokalisierungspfad und keine kurzfristige vollständige Ersetzung bestehender globaler Lieferketten.

Gesamtbild: Drei Geschwindigkeiten

Status	Bewertung Juli 2026
Baugruppenfertigung	Weit fortgeschritten und wirtschaftlich tragfähig, insbesondere für Konsumelektronik. Die Kompetenz für komplexere und zertifizierungsintensive Produkte wächst, befindet sich jedoch noch im Aufbau.
PCB-Fertigung	Solide Basis im Standardsegment (4–8 Lagen) mit zunehmenden Investitionen in höhere Technologien. HDI, komplexe Multilayer und Flex-Rigid-Anwendungen bleiben 2026 jedoch noch Ausnahmebereiche.
Materialbeschaffung	Hohe strukturelle Abhängigkeit von internationalen Lieferketten, insbesondere bei Halbleitern, Laminaten und Spezialmaterialien. Eine deutliche Reduzierung dieser Abhängigkeiten ist ein langfristiger Entwicklungsprozess.

Einschätzung – Was das für die Beschaffungspraxis bedeutet

Eine pauschale Verlagerung der Elektronikfertigung „nach Indien“ stellt derzeit für keinen der drei Wertschöpfungsbereiche eine vollständige 1:1-Alternative zu bestehenden China-Strukturen dar.

Insbesondere bei der Baugruppenfertigung kann Indien bereits heute eine strategisch relevante Ergänzung innerhalb globaler Fertigungsnetzwerke sein. Bei Leiterplatten und Komponenten bleibt die Abhängigkeit von etablierten asiatischen Lieferketten jedoch bestehen.

Unternehmen, die Fertigung nach Indien verlagern, reduzieren daher nicht automatisch sämtliche Abhängigkeiten. Häufig verändert sich vielmehr die Struktur der Lieferkette: Die Montage erfolgt lokal, während kritische Vorprodukte und Komponenten weiterhin aus bestehenden globalen Quellen bezogen werden

Was bedeutet das für Europa?

Für europäische Unternehmen entsteht daraus eine strategische Doppelaufgabe: Einerseits werden weitere Fertigungsstandorte in Asien – darunter zunehmend auch Indien – als Teil einer Risikodiversifizierung aufgebaut. Andererseits wächst die Bedeutung einer eigenen europäischen Elektronik-Infrastruktur, um kritische Abhängigkeiten langfristig zu reduzieren.

Diese beiden Entwicklungen stehen nicht im Widerspruch zueinander. Moderne Lieferketten werden künftig stärker auf mehreren Standorten, regionalen Fähigkeiten und unterschiedlichen Absicherungsmechanismen basieren.

Trend 1: Weitere Diversifizierung nach Asien

Die „China+1“-Strategie, die Indien als Fertigungsstandort stärkt, beeinflusst auch europäische Beschaffungsentscheidungen. Wo bislang häufig ausschließlich China betrachtet wurde, prüfen Unternehmen zunehmend Indien, Vietnam und weitere südostasiatische Länder als zusätzliche Produktionsstandorte. Dabei geht es in der Regel nicht um einen vollständigen Ersatz Chinas, sondern um eine breitere Verteilung von Produktionsrisiken und eine höhere Versorgungssicherheit durch zusätzliche Fertigungsoptionen.

Komplexität statt Stückzahl

Gleichzeitig bleibt der asiatische EMS-Markt vor allem auf hohe Stückzahlen und kostenorientierte Elektronikfertigung ausgerichtet. Für komplexe, regulierte oder variantenreiche Produkte prüfen viele europäische OEMs zunehmend Fertigungspartner innerhalb Europas. Welche Produktgruppen davon besonders betroffen sind, wird im folgenden Abschnitt näher erläutert.

Trend 2: Aufbau einer europäischen Elektronik-Infrastruktur

Parallel zur Diversifizierung außerhalb Europas gewinnt der Aufbau eigener technologischer Fähigkeiten an Bedeutung. Ziel ist dabei nicht eine vollständige Autarkie, sondern eine höhere strategische Handlungsfähigkeit durch Schlüsselkompetenzen innerhalb Europas [8][9].

Der Ansatz lässt sich mit dem Prinzip „Sovereignty through Indispensability“ beschreiben: Europa muss nicht jede Technologie vollständig selbst herstellen, benötigt aber ausreichend eigene Fähigkeiten und Wertschöpfungsanteile, um in kritischen Bereichen unabhängig entscheiden und handeln zu können [10].

Welche Baugruppen davon konkret betroffen sind

Zwei Kategorien erfordern eine besondere Betrachtung – insbesondere dort, wo Standortentscheidungen nicht allein über Stückkosten oder Produktionsvolumen getroffen werden können.

Hochsensible Baugruppen: unabhängig von der Losgröße

Für Baugruppen in der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie im sicherheitsrelevanten Automotive-Bereich (beispielsweise Bremssysteme, Airbag-Steuerungen oder ADAS-Komponenten) sprechen mehrere Faktoren für eine europäische Fertigung:

- **Zulassungs- und Zertifizierungsanforderungen:** Änderungen am Fertigungsstandort oder an qualitätsrelevanten Prozessen können bei MDR-, DO-160- oder ISO-26262-relevanten Produkten umfangreiche Requalifizierungen erforderlich machen.
- **Haftung und Rückverfolgbarkeit:** Bei sicherheitskritischen Produkten ist eine vollständige Dokumentation von Material, Fertigungsprozessen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Lebenszyklus erforderlich.
- **Geopolitisches Risiko:** Kritische Produkte sollten nicht ausschließlich von politischen Entscheidungen, Exportkontrollen oder Handelsbeschränkungen einzelner Drittstaaten abhängig sein.
- **Schutz geistigen Eigentums:** Besonders in Verteidigung, Luftfahrt und technologisch sensiblen Bereichen ist der Schutz von Entwicklungsdaten und Fertigungs-Know-how ein wesentlicher Standortfaktor.

Bei diesen Anwendungen ist eine europäische Fertigung daher häufig unabhängig von Losgröße oder Produktionsvolumen sinnvoll. Entscheidend sind nicht primär Stückkosten, sondern Faktoren wie Sicherheit, Compliance, Kontrolle und langfristige Lieferfähigkeit

Standard-Baugruppen in kleinen bis mittleren Losgrößen: Standortfrage anders bewerten

Auch außerhalb sicherheitskritischer Anwendungen gibt es eine zweite Kategorie, bei der europäische Fertigungsstandorte zunehmend Vorteile bieten können: kleine bis mittlere Losgrößen mit häufigen Änderungen, hoher Variantenvielfalt oder unsicherer Bedarfsplanung.

Bei diesen Produkten wirken sich mehrere Faktoren aus:

- **Lieferzeiten und Mindestbestellmengen:** Lange Transportwege und größere Vorlaufzeiten passen häufig nicht zu volatiler Nachfrage oder kurzfristigen Anpassungen.

- **Änderungsmanagement:** Anpassungen an Stücklisten, Designs oder Fertigungsprozessen verursachen über große Entfernungen und mehrere Zeitzonen hinweg zusätzlichen Koordinationsaufwand.
- **Gesamtkostenbetrachtung:** Bei kleineren Stückzahlen relativiert sich ein möglicher Lohnkostenvorteil. Gleichzeitig gewinnen Faktoren wie Logistik, Zoll, Kapitalbindung, Bestände und operative Flexibilität an Bedeutung.

Zusätzliche regulatorische Treiber

Neben wirtschaftlichen Faktoren erhöhen neue europäische Vorgaben die Bedeutung transparenter und nachvollziehbarer Lieferketten. Der Digital Product Passport im Rahmen der Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) erfordert künftig umfangreiche Produkt- und Nachhaltigkeitsinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts [12].

Der Cyber Resilience Act (CRA) führt für vernetzte Produkte zusätzliche Anforderungen an Cybersicherheit, Schwachstellenmanagement und Dokumentation ein. Hersteller müssen ab dem 11. September 2026 Meldepflichten für aktiv ausgenutzte Schwachstellen erfüllen; die vollständigen Anforderungen einschließlich CE-Kennzeichnung gelten ab Dezember 2027 [13].

Parallel verlangt die NIS2-Richtlinie von betroffenen Unternehmen eine stärkere Absicherung ihrer Lieferketten und eine Bewertung von Risiken bei kritischen Zulieferern [14]. Für Baugruppen mit Firmware oder Konnektivität wird eine nachvollziehbare, auditierbare Lieferkette damit zunehmend zu einem wichtigen Auswahlkriterium.

Einschätzung – Fazit

Indien verändert die globale Landkarte der Elektronikfertigung – jedoch nicht in allen Bereichen mit gleicher Geschwindigkeit. Die größten Fortschritte zeigen sich derzeit bei der Baugruppenfertigung, während Materialabhängigkeiten und bestimmte Schlüsseltechnologien weiterhin eine zentrale Herausforderung bleiben.

Europa reagiert darauf nicht mit einem Rückzug aus asiatischen Fertigungsregionen, sondern mit einer Doppelstrategie: einer weiteren Diversifizierung der Lieferketten außerhalb Europas und dem gleichzeitigen Aufbau größerer Resilienz sowie technologischer Fähigkeiten innerhalb Europas. Diese beiden Entwicklungen ergänzen sich und verfolgen dasselbe Ziel: die Verringerung kritischer Abhängigkeiten und eine höhere Versorgungssicherheit.

Für viele Standardprodukte mit hohen Stückzahlen bleiben asiatische Fertigungsstandorte auch künftig wirtschaftlich sinnvoll. Bei sicherheitsrelevanten Baugruppen sowie bei kleinen bis mittleren Losgrößen mit hoher Variantenvielfalt gewinnen europäische Standorte dagegen zunehmend an strategischer Bedeutung. Entscheidend sind dabei weniger reine Stückkosten als Faktoren wie Zertifizierung, Rückverfolgbarkeit, Reaktionsfähigkeit, regulatorische Anforderungen und die Gesamtkosten über den gesamten Produktlebenszyklus.

Für die Praxis bedeutet dies: PCB-Fertigung, Baugruppenfertigung und Materialbeschaffung sollten getrennt bewertet werden. Ebenso sollten die kurzfristige Beschaffungsentscheidung („Wo lasse ich heute fertigen?“) und die langfristige Standortstrategie („Wie erhöhe ich die Resilienz meiner Lieferkette?“) nicht miteinander vermischt werden. Pauschale Standortentscheidungen für das gesamte Elektronikportfolio werden der Entwicklung im Jahr 2026 nicht mehr gerecht.

Auch für Europa selbst relevant

Die gleiche Diversifizierungslogik gilt innerhalb Europas. Auch europäische Unternehmen prüfen zunehmend mehrere Fertigungsstandorte innerhalb der Region, um Abhängigkeiten zu reduzieren und Lieferketten robuster aufzustellen.

Neben etablierten Industriestandorten in Westeuropa gewinnen insbesondere Länder in Mittel- und Osteuropa an Bedeutung. EMS-Standorte in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien verfügen über gewachsene industrielle Strukturen, qualifizierte Fachkräfte und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.

Dabei geht es nicht um eine reine Verlagerung in kostengünstigere Regionen, sondern um die strategische Ergänzung bestehender Fertigungsnetzwerke. Faktoren wie Kundennähe, kurze Transportwege, regulatorische Sicherheit, direkte Kommunikation und schnelle Reaktionsfähigkeit gewinnen insbesondere bei komplexeren Baugruppen sowie kleinen und mittleren Losgrößen zunehmend an Bedeutung.

Eine robuste europäische Lieferkette wird daher künftig weniger durch einen einzelnen Fertigungsstandort definiert, sondern durch ein ausgewogenes Netzwerk aus regionalen EMS-Partnern, internationalen Zweitquellen und strategisch ausgewählten Produktionsstandorten.

Weiterführende Publikationen

Eine vertiefende Betrachtung der strategischen Verlagerung von Elektronikfertigungsaufträgen und der Bedeutung europäischer Fertigungsstandorte wurde in der Fachzeitschrift EPP – Elektronik Produktion & Prüftechnik veröffentlicht:

„Elektronikfertigungsaufträge strategisch verlagern“

Quellenverzeichnis

Alle Quellen sind frei zugänglich, ohne Bezahlschranke, Abo oder Registrierpflicht (Stand: Juli 2026).

[1] EE Times: India Budget 2026-2027 – Semiconductors, Manufacturing, and Tax Reforms – <https://www.eetimes.com/india-budget-2026-2027-semiconductors-manufacturing-and-tax-reforms/>

[2] Free Press Journal: India Approves ₹41,863 Crore Investment From Foxconn, Dixon, Tata & Samsung – <https://www.freepressjournal.in/tech/india-approves-41863-crore-investment-from-foxconn-dixon-tata-samsung>

[3] Manufacturing Today India: #TOP10 – India's electronics manufacturers who's powering the PLI push – <https://www.manufacturingtodayindia.com/top10-indias-electronics-manufacturers-whos-powering-the-pli-push>

[4] KPMG India: From Assemblers to Innovators – India's ₹22,919 Cr Push to Dominate Electronics Components – <https://kpmg.com/in/en/blogs/2025/05/from-assemblers-to-innovators-indias-22919-cr-push-to-dominate-electronics-components.html>

- [5] CNBC: India is dependent on China for electronic components. Now it's trying to change that – <https://www.cnbc.com/2025/10/29/india-is-dependent-on-china-for-electronic-components-now-its-trying-to-change-that-.html>
- [6] Observer Research Foundation (ORF): India's Semiconductor Ambitions and Global Competitiveness – Confronting the China Challenge – <https://www.orfonline.org/research/india-s-semiconductor-ambitions-and-global-competitiveness-confronting-the-china-challenge>
- [7] Zbotic: PCB Industry India – Market Size, Players, and Trends 2026 – <https://zbotic.in/pcb-industry-india-market-size-players-and-trends-2026/>
- [8] European Commission: EU Tech Sovereignty – Shaping Europe's digital future – <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-tech-sovereignty>
- [9] Geopolitical Monitor: Defense Industry Is the Missing Link in EU Semiconductor Sovereignty – <https://www.geopoliticalmonitor.com/defense-industry-is-the-missing-link-in-eu-semiconductor-sovereignty/>
- [10] The Economy: Sovereignty Through Indispensability – Europe's Realistic Path in the Global Chip Race – <https://economy.ac/research/2026/05/202605289164>
- [11] EPP – Elektronik Produktion & Prüftechnik: Elektronikfertigungsaufträge strategisch verlagern – <https://epp.industrie.de/news/elektronikfertigungsauftraege-strategisch-verlagern/>
- [12] European Commission: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) – Digital Product Passport – https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products-regulation_en
- [13] European Commission: Cyber Resilience Act – Shaping Europe's digital future – <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cyber-resilience-act>
- [14] European Commission: NIS2 Directive – Shaping Europe's digital future – <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/nis2-directive>

Über den Autor

Dirk Kaussen ist Gründer und Geschäftsführer der EMS Strategy Group. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in der Elektronikindustrie — darunter die Gründung einer eigenen Elektronikfertigung in Deutschland — verfügt er über tiefgreifende Expertise in Fertigungsprozessen, EMS-Partnerauswahl, Lieferkettenstabilität, Verlagerungsprojekten und Risikomanagement. Sein Ansatz verbindet praxisnahe Lösungen mit direktem Bezug zur industriellen Realität.

Über die EMS Strategy Group

Die EMS Strategy Group unterstützt Industrieunternehmen bei der strategischen Weiterentwicklung und Optimierung ihrer Elektronikfertigung – von der übergeordneten Planung bis zur operativen Umsetzung. Der Schwerpunkt liegt auf der strategischen Verlagerung von Fertigungsvolumina zu europäischen EMS-Dienstleistern, dem Aufbau neuer Produktionskapazitäten sowie der Erweiterung bestehender Fertigungsstrukturen.

Darüber hinaus entwickelt die EMS Strategy Group belastbare Lieferkettenkonzepte, führt umfassende Risikoanalysen durch und begleitet Dual-Sourcing-Strategien zur Absicherung und Stabilisierung von Lieferketten. Auf Wunsch werden Projekte bis zum erfolgreichen Serienhochlauf operativ begleitet.

Rechtlicher Hinweis / Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Analysen und Empfehlungen wurden mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Sie dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken im B2B-Kontext und stellen keine Rechts-, Steuer-, technische oder betriebswirtschaftliche Beratung dar, die auf eine spezifische Situation zugeschnitten ist. Die Inhalte dieses Dokuments können und sollen eine individuelle, qualifizierte Fachberatung oder wirtschaftliche Machbarkeitsstudien nicht ersetzen. Alle genannten Markt-, Statistik- und Brancheninformationen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Regulatorischer Vorbehalt: Da sich gesetzliche Vorgaben, Richtlinien, Normen und deren offizielle Auslegungsvorschriften (insbesondere auf EU- und internationaler Ebene) kontinuierlich weiterentwickeln, spiegeln alle Angaben den Stand zum Zeitpunkt der Erstellung wider. Sie stehen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt späterer offizieller Veröffentlichungen oder Gesetzesänderungen. Ausschließlich die offiziellen Gesetzestexte und behördlichen Publikationen sind rechtsverbindlich.

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss: Obwohl alle zumutbaren Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, übernimmt die EMS Strategy Group keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte.

Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung der EMS Strategy Group für direkte, indirekte, zufällige, Folge- oder sonstige Schäden ausgeschlossen, die aus der Nutzung, dem Vertrauen auf oder der praktischen Umsetzung von Informationen, Strategien, Empfehlungen oder Bewertungskriterien dieses White Papers entstehen.

Urheberrecht und Weitergabe: Dieses Dokument darf in seiner ursprünglichen, unveränderten Form weitergegeben und geteilt werden, vorausgesetzt, die vollständige Nennung und Urheberbezeichnung der EMS Strategy Group bleibt jederzeit erhalten.



www.emssg.com | LinkedIn: Dirk Kaussen

© 2026 EMS Strategy Group. Alle Rechte vorbehalten. Dieses White Paper darf mit Quellenangabe frei zitiert werden.